

第十届材料基因工程国际论坛

第一轮通知

材料基因工程是“人工智能+材料”的先导，推动了材料智能研发新理念、新范式的形成和关键技术的发展，有力支撑了材料领域科技革命和产业变革。材料基因工程国际论坛自 2017 年至今已成功举办九届，聚焦材料高效计算、变革性实验技术、材料大数据技术和“AI+新材料”产业应用等方向，开展深入研讨和交流。迄今共有 350 余位（次）海内外院士，超过 20 个国家和地区的 450 余位（次）海外代表、超万位（次）国内代表参会，在国内外产生了较大影响。

为进一步促进人工智能融合的材料基因工程基础理论、前沿技术和关键装备的发展，加速材料领域“人工智能+”科技创新和产业应用，由全国新材料大数据创新联盟、中国材料研究学会主办，济南新旧动能转换起步区、山东大学、上海思朗科技股份有限公司、北京科技大学、北京云智材料大数据研究院、济南先行投资集团有限责任公司、山东辉石基金、山东未来先导基金公司等联合承办的“第十届材料基因工程国际论坛”定于 2026 年 11 月 2-6 日在山东省济南市召开。

论坛主题（暂定）

1. 材料高效计算设计论坛：
 - a) AI 赋能的材料高效计算与跨尺度设计分会场
 - b) AI 驱动的综合计算材料工程分会场
 - c) 计算主导的新材料自主迭代筛选与闭环验证分会场
2. 材料变革性实验技术论坛：
 - a) 高通量智能实验技术与装备分会场
 - b) 大模型/智能体驱动的自主实验分会场

- c) AI 赋能的材料实验与制造分会场
- 3. 材料科学智能与大数据论坛：
 - a) 材料智能算法与应用分会场
 - b) 材料大模型分会场
 - c) 材料数据与基础设施分会场
- 4. “AI+新材料” 产业应用论坛：
 - a) 智赋新能：先进能源核心材料产业分会场
 - b) 智赋新芯：未来芯片关键材料产业分会场
 - c) 智造精工：高端装备结构材料产业分会场
 - d) 智慧化工：化学化工战略材料产业分会场
 - e) 智慧健康：生物医用先进材料产业分会场
 - f) 智创未来：资本赋能材料产业对接与路演活动
- 5. 一带一路国际论坛

注：欢迎有兴趣的专家学者组织申办分会场；
欢迎企业或团队参与技术展览、供需发布、成果发布、路演等活动。



时间节点

- 7月31日：口头报告摘要投稿截止
- 8月31日：研究生墙报投稿截止
- 10月15日：在线注册及优惠截止
- 11月2日：现场注册
- 11月3日：开幕式及大会报告
- 11月4-5日：分会场报告、技术会议、需求发布、路演活动等
- 11月6日：其他活动及返程

论坛征文

论坛将邀请国内外知名专家做主论坛和分论坛主旨报告，同时欢迎广大科技人员积极投稿，由论坛组织专家评审后择优录用，安排口头报告或墙报，优秀论文全文可推荐至《材料基因工程前沿（英文）》期刊正式发表。口头报告中英文摘要及报告人简介请在论坛官网 www.formge.cn 线上提交，或发送至邮箱 mge@ustb.edu.cn（模版请在官网下载）。论坛同时设墙报展示环节，欢迎研究生踊跃投稿，墙报摘要及作者联系方式请通过论坛官网 www.formge.cn 线上提交。

论坛奖励

为促进材料基因工程领域的学术研究、技术创新和成果应用，激发科技人员的创新动力，论坛设有“杭实材料基因工程杰出贡献奖”、“杭州青山湖材料基因工程青年科学家奖”、优秀青年科学家报告奖、优秀研究生墙报奖，欢迎参会人员积极申报，请于2026年8月31日前将提名/申报材料（模板见论坛官网 www.formge.cn）发送至邮箱 mge-w@ustb.edu.cn。

联系方式

论坛网址：www.ForMGE.cn

联系邮箱：mge@ustb.edu.cn（咨询、报告摘要）

mge-p@ustb.edu.cn（墙报投稿）

联系方式：李娜 15953787767（分会场咨询、国际参会）

王冠杰 13261670688（报告及墙报投稿）

白玲 13430355671（注册、参展等）

微信公号：北京云智材料大数据研究院

